

Judul:

Studi pengaruh penambahan Cu terhadap karakteristik struktur, sifat termal dan sifat kekerasan dari paduan Sn-Cu = Study of Cu addition effect to structures, thermal and hardness characteristics of Sn-Cu alloys

Pengarang/Penulis:

Muhammad Hafiz Sjafril, author

Subjek:

Solder and soldering ; Lead-free electronics manufacturing processes

Nomor Panggil:

S29361

Penerbitan:

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)